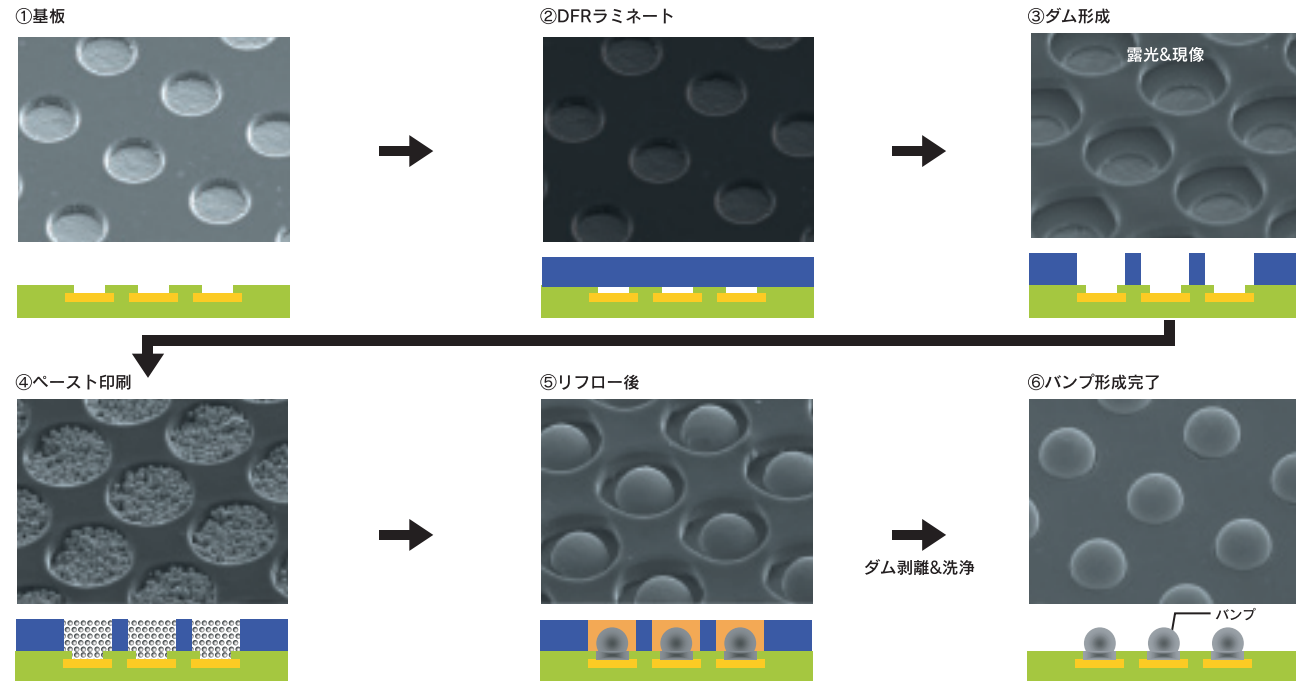


スーパーソルダー:はんだプリコート

エリアアレイ基板/プリコートプロセス

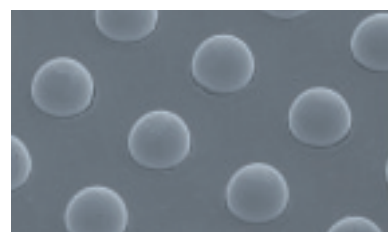
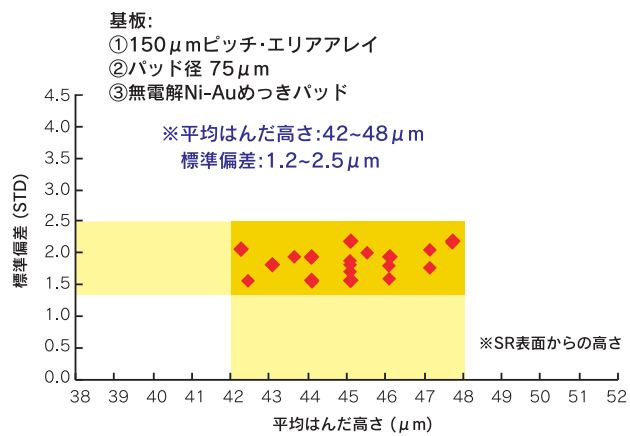
エリアアレイタイプのファインピッチ基板へはドライフィルムレジストによるダム層を利用したソルダーダムプリコート法により高さバラツキの少ないはんだバンプ形成を実現。



Specifications

項目		代表値				特記事項
合金組成		Sn-Pb	Sn-Ag-Cu	Sn-Ag	Sn-Cu	
金属種	Sn	63.0%	96.5%	96.5%	99.3%	
	Ag		3.0%	3.5%		
	Cu		0.5%		0.7%	
	Pb	37.0%				
ULA対応可(ご相談下さい)						
液相線温度(°C)		183	219	221	227	
固相線温度(°C)		183	217	221	227	
比重		8.4	7.4	7.4	7.4	
強度 (Kgf/mm ²)		4.3	3.6	3.2	3.4	
伸び (%)		32	38	30	28	
プリコート対応ピッチ領域		ペリフェラルバンプ:50~150μm エリアアレイバンプ:100~300μm				
ペリフェラルバンプ 事例	対応ピッチ	60μm				
	バンプ高さ	18μm				グラフ1参照
	高さバラツキ	σ=2μm				グラフ1参照
	パッド幅	幅広部30μm 幅狭部20μm				
	パッド長	幅広部80μm 全長180μm				
	パッド処理	銅				
エリアアレイバンプ 事例	対応ピッチ	150μm				
	バンプ高さ	45μm				グラフ2参照
	高さバラツキ	σ=2μm				グラフ2参照
	レジスト開口	75μm				
	レジスト厚さ	10μm				
	パッド処理	無電解ニッケル-金めっき				ニッケル2~3μm厚 金0.05μm厚

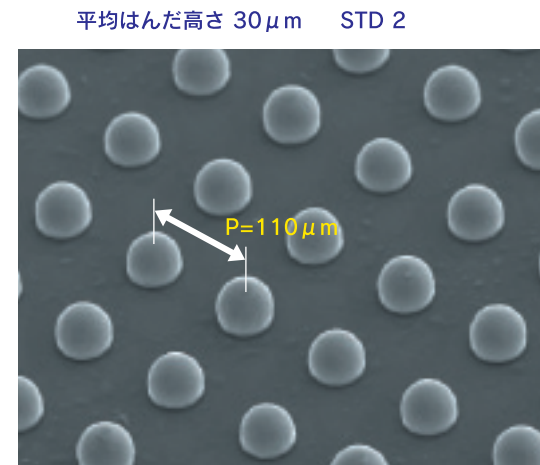
エリアアレイ基板/プリコートはんだ高さ



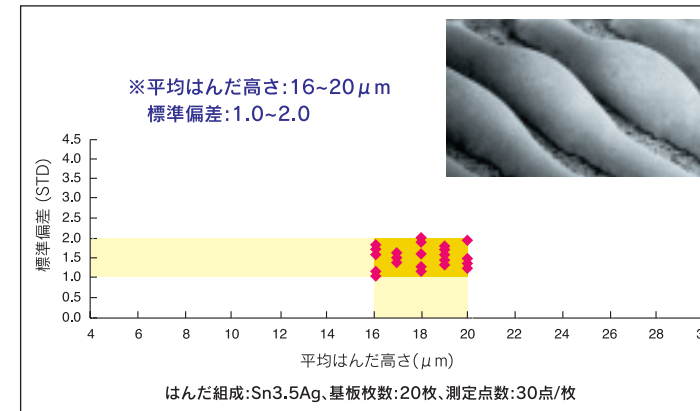
プリコート外観

エリアアレイ/基板プリコート事例

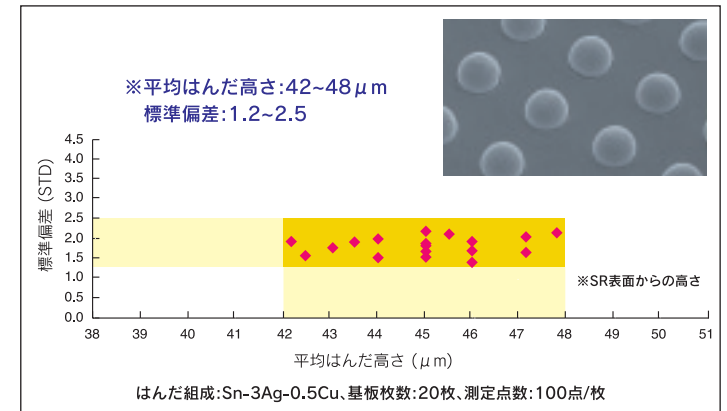
110μmピッチエリアアレイ基板



【グラフ1】プリコートはんだ高さ (ペリフェラル, 60μmピッチ)



【グラフ2】プリコートはんだ高さ (エリアアレイ, 150μmピッチ)



Memo